

102.02.19；102.11.06 課程及選課輔導委員會議通過
 102.02.22；102.11.18 系務會議通過
 102.03.12；102.12.16 工學院課程委員會議通過
 102.03.18；102.12.23 教務會議通過

正修科技大學 雙軌訓練旗艦班 日間部四技電子工程系微科技組 102 學年度入學新生課程標準

- 說明：1. 畢業總學分至少為 128 學分
 必修 96 學分[含通識基礎必修 10 學分，專業必修 86 學分]
 選修 32 學分[含通識博雅選修 12 學分，專業選修 20 學分](跨系選修至多 10 學分)
 2. 工廠實習(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)係在業界實習的課程。
 3. 職場倫理與文化包含職場倫理、勞動法規與勞工安全等課程；人際關係與溝通涵蓋人際溝通與生涯規劃等認證課程。
 4. 電路學與電子學涵蓋電子電路學認證課程；計算機概論為微算機原理認證課程；數位邏輯為數位邏輯設計認證課程；電子實習、封裝材料特性涵蓋電子材料認證課程；晶圓製程技術、晶圓製程設備、半導體製程整合涵蓋半導體製程認證課程；半導體封裝技術涵蓋電子構裝、顯微鏡結構觀察及其試片準備認證等課程；嵌入式系統介面設計為嵌入式系統認證課程；品質管理為品質管理認證課程。

| 一年級上學期 | | | | 一年級下學期 | | | |
|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|
| 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 | 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 |
| 通識基礎必修 | 403001 | 國文(一) | 2/2 | 通識基礎必修 | 403002 | 國文(二) | 2/2 |
| 通識基礎必修 | 403003 | 英文(一) | 3/3 | 通識基礎必修 | 403004 | 英文(二) | 3/3 |
| 通識博雅選修 | 300BE1 | 職場倫理與文化 | 2/2 | 通識博雅選修 | 300CH7 | 科技與社會 | 2/2 |
| 專業必修 | 403A26 | 微積分 | 3/3 | 專業必修 | 403A39 | 數位邏輯 | 3/3 |
| 專業必修 | 403A27 | 電路學 | 3/3 | 專業必修 | 403A38 | 計算機概論 | *△ 3/3 |
| 專業必修 | 403A63 | 工廠實習(一) | △ 4/6 | 專業必修 | 403A64 | 工廠實習(二) | △ 4/6 |
| 本學期預定開課 17 學分 19 小時 | | | | 本學期預定開課 17 學分 19 小時 | | | |
| 二年級上學期 | | | | 二年級下學期 | | | |
| 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 | 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 |
| 通識博雅選修 | 300A44 | 邏輯與思考 | 2/2 | 通識博雅選修 | 300B50 | 人際關係與溝通 | 2/2 |
| 專業必修 | 403A83 | 程式設計 | *△ 3/3 | 專業必修 | 403B02 | 品質管理 | 3/3 |
| 專業必修 | 403A60 | 電子學 | 3/3 | 專業必修 | 403A71 | 半導體元件物理 | 3/3 |
| 專業必修 | 403B01 | 電子實習 | △ 3/3 | 專業必修 | 403B03 | 晶圓製程技術 | 3/3 |
| 專業必修 | 403A48 | 嵌入式系統概論 | △ 3/3 | 專業必修 | 403A51 | 嵌入式系統介面設計 | △ 3/3 |
| 專業必修 | 403A65 | 工廠實習(三) | △ 4/6 | 專業必修 | 403A66 | 工廠實習(四) | △ 4/6 |
| 本學期預定開課 18 學分 20 小時 | | | | 本學期預定開課 18 學分 20 小時 | | | |
| 三年級上學期 | | | | 三年級下學期 | | | |
| 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 | 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 |
| 專業必修 | 403B04 | 晶圓製程設備 | 3/3 | 通識博雅選修 | 300AE3 | 設計與創作 | 2/2 |
| 專業必修 | 403B05 | 封裝材料特性 | 3/3 | 專業必修 | 403A55 | 光電元件 | 3/3 |
| 專業必修 | 403A56 | 半導體元件與製程模擬實習 | *△ 3/3 | 專業必修 | 403B07 | 半導體封裝技術 | 3/3 |
| 專業必修 | 403B06 | 基礎光學 | 3/3 | 專業必修 | 403A35 | 工廠實習(六) | △ 4/6 |
| 專業必修 | 403A34 | 工廠實習(五) | △ 4/6 | 專業選修 | 403N16 | 半導體廠務實習 | △ 3/3 |
| 本學期預定開課 16 學分 18 小時 | | | | 本學期預定開課 15 學分 17 小時 | | | |
| 四年級上學期 | | | | 四年級下學期 | | | |
| 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 | 科目類別 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分/時數 |
| 專業必修 | 403A98 | 工廠實習(七) | △ 4/6 | 通識博雅選修 | 300D98 | 運動與體適能 | 2/2 |
| 專業選修 | 403N59 | 半導體製程整合 | 3/3 | 專業必修 | 403A99 | 工廠實習(八) | △ 4/6 |
| 專業選修 | 403N60 | 半導體可靠度分析 | 3/3 | 專業選修 | 403N61 | 太陽能電池製程設備與技術實習 | △ 3/3 |
| 專業選修 | 403N69 | 太陽能電池概論 | 2/2 | 專業選修 | 403N62 | 半導體封裝模擬實習 | *△ 3/3 |
| 專業選修 | 403N22 | 半導體量測實習 | △ 3/3 | | | | |
| 本學期預定開課 15 學分 17 小時 | | | | 本學期預定開課 12 學分 14 小時 | | | |

備註：△表實習(驗)課程、*表上機課程。